

製品仕様書  
PRODUCT  
SPECIFICATION

---

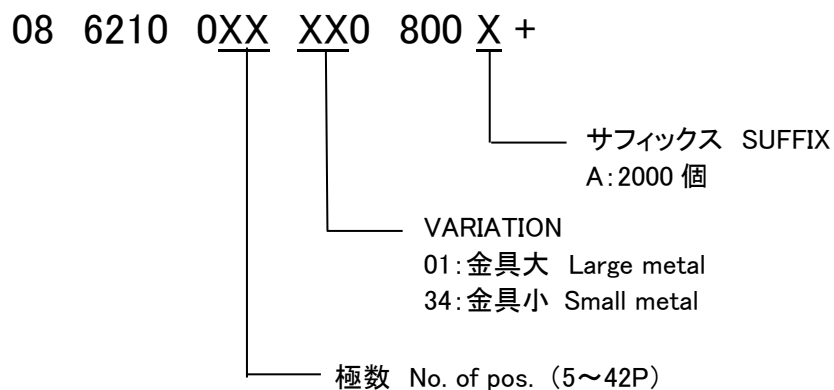
*6210Series*

0.5mm PITCH FPC/FFC CONNECTOR  
(Sn-Cu PLATED)

京セラ株式会社  
KYOCERA Corporation

D	DCN20730	2020/07/28	N. Kitagawa		M. Yoshida
C	DCN20674	2020/07/07	N. Kitagawa		M. Yoshida
O	EDN-671	2006/09/19	K. Murakami	A. Hagiwara	T. Satoh
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

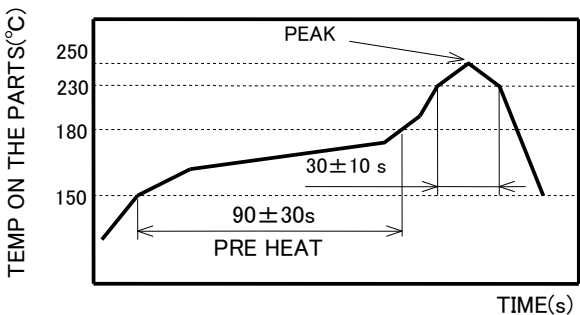
1. 品名 FPC/FFC CONNECTOR
2. 形式 0.5 mm PITCH FPC/FFC CONNECTOR (Sn-Cu PLATED)
3. 適用範囲 Scope  
 本仕様書は 6210 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。  
 This specifies 6210 Series 0.5mm pitch FPC/FFC connector.
4. 関連規格 Related documentation
  - ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧  
 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-  
 Part 1-100:General-Applicable publications
  - ・JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧  
 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-  
 Part 1-100:General-Applicable publications
  - ・JIS C 5402:1992 電子機器用コネクタの試験法  
 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material  
 図面参照 Refer to drawings.
6. 型番 Part numbering



## 仕様 Spec

## 嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件・方法 Condition	規格 Specification
7.一般 General	1	定格電流 Current rating	—	DC 0.4A/contact
	2	定格電圧 Voltage rating	—	DC 50V/contact
	3	使用温湿度範囲 Operation environment	—	−40℃ ~ 85℃ 95% RH MAX. 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 通電による温度上昇分も含む。 Ice-free at the low temperature No condensation shall occur Including terminal temperature rise
	4	保存温湿度範囲 Storage environment	梱包状態にて While packed	−20℃ ~ 60℃ 60% RH MAX. 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 Ice-free at the low temperature No condensation shall occur
8.機械的 Mechanical	1	外観 Appearance	目視 Visual inspection	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形等のないこと。 No rust, contamination, damage or deformation effecting on function.
	2	スライダ挿入力 Slider insertion force	25mm/min. / 10 times	初回 Initial / 10 回後 10times FPC 1.24 N /pin MAX. FFC 1.24 N /pin MAX.
	3	スライダ抜去力 Slider separation force	25mm/min. / 10 times	初回 Initial / 10 回後 10times FPC 0.19 ~ 1.24 N /pin FFC 0.19 ~ 1.24 N /pin
	4	コンタクト保持力 Contact retention force	25mm/min.	4N MIN.
	5	挿抜耐久性 Durability	無通電状態で Without current applied 10 times/min., 10 times	外観 Appearance 素地の露出がないこと。 Conductor shall not be exposed. 接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX
	6	FPC/FFC 保持力 FPC/FFC retention force	25mm/min.	初回 Initial / 10 回後 10times FPC 0.18 N /pin MIN. FFC 0.12 N /pin MIN.
	7	振動 Vibration	10~55~10Hz/min. /1.5mm (peak to peak) /DC 100mA (2h per direction; XYZ, 6h in total) IEC 60068-2-6:1995 JIS C 60068-2-6:1999	瞬断 Discontinuity 1 μs MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック等ないこと。 No damage, loose part or crack. 接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX

	8	衝撃 Shock	50 G / 11 ms / DC 100mA (3times per direction; XYZ) <b>IEC 60068-2-27:1972</b> <b>JIS C 60068-2-27:1995</b>	瞬断 Discontinuity 1 $\mu$ s MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack
	9	はんだ付性 Solderability	245 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C / 3 $_{-1}^{0}$ sec. immersion <b>IEC 60068-2-20:1979</b> <b>JIS C 60068-2-20:1996</b>	浸漬部にはんだが 95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder.
	10	はんだ耐熱性 Resistance to solder heat	<p>&lt;手はんだ Hand soldering&gt; はんだごて温度 Bit temperature 350<math>\pm</math>10<math>^{\circ}</math>C 3 <math>_{0}^{+1}</math> sec. <b>IEC 60068-2-20:1979</b> <b>JIS C 60068-2-20:1996</b></p> <p>&lt;リフロー Reflow&gt; 下記プロファイル参照 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250<math>^{\circ}</math>C (コネクタ表面) (On the surface connector) <b>(Modified) IEC 60068-2-58:1999</b> <b>JIS C 60068-2-58:2002</b></p>	端子ガタ、変形等ないこと No loose contacts nor deformation.
 <p>TEMP ON THE PARTS(<math>^{\circ}</math>C)</p> <p>250 230 180 150</p> <p>PEAK</p> <p>30 <math>\pm</math> 10 s</p> <p>90 <math>\pm</math> 30s</p> <p>PRE HEAT</p> <p>TIME(s)</p>				
9.電氣的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC 200V、1min. (Leak 2mA) <b>JIS C 5402 (5.1):1992</b>	フラッシュオーバー、スパークオーバー 及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.
	2	絶縁抵抗 Insulation resistance	DC 500V、1min. <b>JIS C 5402 (5.2):1992</b>	初期 Initial : 100M $\Omega$ MIN. 試験後 After test : 100M $\Omega$ MIN.
	3	ローレベル接触抵抗 Low level contact resistance	四端子法にて Four prove method <b>JIS C 5402 (5.3):1992</b>	50m $\Omega$ MAX.

	4	温度上昇 Temperature rise	嵌合状態でコンタクトを直列に結線 Under mated condition, all contacts shall be connected in series. <b>JIS C 5402 (5.10): 1992</b>	定格電流にて at the Current rating 30K MAX.		
10.耐環境 Environment	1	硫化水素 H <sub>2</sub> S	40±2 °C / 75% RH / 3±1ppm / 96h <b>IEC 60068-2-43:1976</b> <b>JIS C 60068-2-43:1993</b>	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX. 外観 Appearance 著しい腐食が生じないこと。 No evident corrosion.		
	2	塩水噴霧 Salt mist	5±1weight% / 35±2°C / 48h <b>IEC 60068-2-11:1981</b> <b>JIS C 60068-2-11:1989</b>	外観 Appearance 著しい腐食が生じないこと。 No evident corrosion.		
	3	温度サイクル Temperature cycling	5 cycles (Modified) <b>IEC 60068-2-14:1984、 -33:1971</b> <b>JIS C 0025:1988</b>	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX 外観 Appearance 異常がないこと。 Without distinct damage.		
			段階 Step		温度(°C) Temperature	時間(分) Time(min.)
			1		-55±3	30
			2		25± <sup>10</sup> <sub>5</sub>	5 MAX.
			3		85±2	30
	4	25± <sup>10</sup> <sub>5</sub>	5 MAX.			
4	湿度 Moisture resistance	40°C / 90~95% RH / 96h <b>IEC 60068-2-3:1969</b> <b>JIS C 60068-2-3:1987</b>	絶縁抵抗 Insulation resistance 100 MΩ MIN. 接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX 耐電圧 Dielectric withstanding voltage フラッシュオーバー、スパークオー バー及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.			
5	高温加速(寿命) High temperature (Life)	85±2°C / 96h <b>IEC 60068-2-2:1974</b> <b>JIS C 60068-2-2:1995</b>	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX.			
6	耐寒性 Cold resistance	-40±3°C / 48h <b>IEC 60068-2-1:1990</b> <b>JIS C 60068-2-1:1995</b>	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX			
7	耐アンモニア NH <sub>3</sub> resistance	28%のアンモニア水 ammonia water / 25±3°C / 40 min	接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX			

## 取り扱い注意事項 Precautions

### 1 FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC

FPC/FFC の屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようにご注意ください。

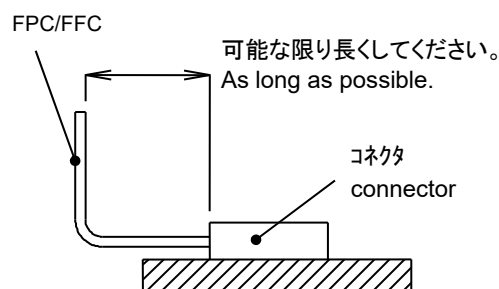
尚、FPC/FFC をコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。

条件によっては弊社にて評価確認を行います。

Pay attention not to apply an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC.

Please contact us when your FPC/FFC have to be bent repeatedly near the opening for card insertion.

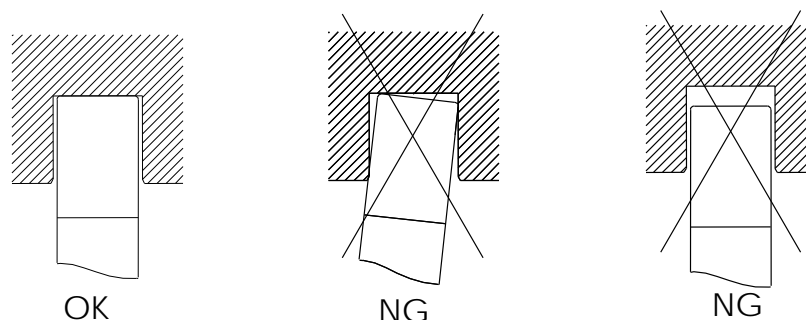
Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.



### 2 FPC/FFC の挿入について FPC/FFC insertion and separation

FPC/FFC はカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。

Insert the FPC/FFC vertically until it hits to the slot end.



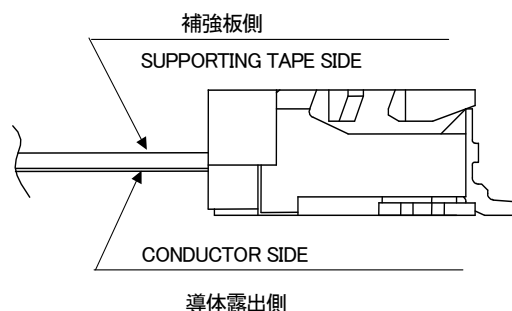
検査工程等で FPC/FFC の挿抜を行う際は、最終組み込み用 FPC/FFC よりも薄い FPC/FFC を使用願います。

For the FPC/FFC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC/FFC than those for final assembling.

### 3 FPC/FFC の方向性 Direction of FPC/FFC

図のように導体露出面を下にし、補強板が上側になるように装着して下さい。

FPC/FFC shall be inserted as shown below with conductor side down and supporting tape side up.



#### 4 スライダー操作 Slider operation

コネクタの破損防止の為、スライダー操作は基板に半田付け後行うようにして下さい。  
After soldering, a slider shall be operated to prevent damage to a connector.

#### 5 実装について Mounting

本製品は低背、省面積化を実現する為、インシュレータが非常に薄肉になっております。  
従いまして、FPC 基板へのマウント等実装条件につきましては弊社と打合わせの上、確認して頂きますようお願い致します。

また、FPC 実装の場合 FPC のたわみにより半田クラックなどが発生する可能性があります。

この為、実装部にはできるだけ厚い(少なくとも 0.3 mm 以上)補強板を貼り付けることを推奨します。

リフロー加熱によりインシュレータ外表部にふくれが発生する場合がありますが、FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく、実使用上問題はありません。

Thin molding insulators realize the low-profile and small space character of this product.

Mounting conditions on FPC boards, therefore, need to be consulted with us and confirmed.

When an FPC board is connected, deflection in bending the FPC board may cause a solder crack.

In order to prevent it, it is suggested to attach a reinforcing plate that has 0.3 mm or more in thickness to the connecting area on the FPC board.

Although blisters may be formed due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem.

#### 6 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさないよう御願ひ致します。

Insertion and separation under live current shall not be done.

## 特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

- (1) 本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2) 本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。

If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.

- (3) 以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の条件が加わった事が証明された場合。

If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.

2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

## 有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛

Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.